

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-005

### 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称/人员姓名	迅胜投资、君弘投资、尚伟投资、千合并购基金及个人投资者等共14人
时间	2026年6月27日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：冯学裕 董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p><b>Q1、请介绍一下公司进入液冷散热领域的背景和战略考虑。</b></p> <p>答：公司深耕智能卡、半导体产品制造多年，在高导热金属基材、精密蚀刻、电镀、钎焊、洁净制程等工艺方面形成了长期技术沉淀。2018年切入功率半导体封装赛道后，持续积累热相关材料加工能力，随着AI服务器、AIDC智算中心芯片功耗持续攀升、液冷替代风冷产业趋势明确，公司即开始规划液冷散热业务，2025年公司已通过自有资金完成惠州液冷产品生产基地首期产线搭建，并依托台湾客户进入美系头部半导体公司供应链，围绕其下一代高性能计算平台持续开展样品开发、适配验证和小批量交付工作。2026年1月公司同步推出总额不超过8亿元的定增方案，集中资源加码液冷产业化与研发，实现从封装材料向散热结构件、系统级液冷方案的业务延伸。</p>

**Q2、公司液冷业务目前的技术路径、产品覆盖范围如何？**

答：公司液冷业务初期引入日本液冷制造工艺，同步在惠州自搭建本土自主研发团队，形成具备完全自主可控的工艺研发能力与制造体系。目前主要液冷产品包括液冷板、不锈钢波纹管、分水器（Manifold）、快速接头等核心部件。公司深度参与客户产品共同开发，产品可以以整组模组形式向客户交付，在产品形态上，公司在供货管路及零部件的基础上，已具备整组冷板模组的制造与交付能力，并正在推进液冷模组和Inner Manifold（机柜内歧管）的交样验证，后续将持续随客户技术路线迭代至下一代MLCP（微通道封装级液冷）产品。

**Q3、公司液冷产品面向海外市场的客户进展及商业模式是怎样的？**

答：在海外市场，公司主要通过台湾合作伙伴进入美系头部半导体公司供应链，目前已与该客户建立了较为紧密的合作关系，双方共同开发产品，公司在产品质量、交付能力及工艺水平方面获得了客户较高认可，在客户的供应商体系中具备良好的合作地位，公司以其整体工艺导向参与产品研发，为客户提供从冷板、管路、Manifold、液冷模组组件等，并非单纯的外协加工，是其冷板、管路、歧管、模组等核心部件供应商。

**Q4、目前液冷行业整体竞争格局如何？公司有何竞争优势？**

答：当前液冷赛道入局企业持续增多，行业准入壁垒显著：客户验证周期长、精密制造工艺严苛、产品对钎焊密封性、流道一致性、生产洁净度、批次测试稳定性要求极高，工艺爬坡周期长。公司的竞争优势主要体现为：

第一，技术能力方面，公司依托半导体封装多年工艺积累，在高导热金属材料、蚀刻、电镀、钎焊等工艺方面具备长期积累，形成了从材料到结构件再到模组组件的全链条能力；第二，客户资源方面，公司已通过台湾合作伙伴进入美系头部半导体公司供应链，双方在技术理解、工艺储备与迭代节奏上与全球前沿液冷技术迭代保持同步；第三，产能与交付方面，公司在惠州已建立初期的研发与量产产线，具备机加工、焊接、组装、清洗检测等全流程制造能力，为后续规模化交付

奠定基础。

**Q5、公司液冷业务的技术团队构成如何？**

答：公司液冷技术团队核心成员拥有二十年以上精密金属加工、热管理结构件行业经验，精通液冷结构开发、量产工艺优化与大规模交付管控。公司注重自身技术能力的培养与积淀，惠州生产基地已组建了完整独立团队，涵盖产品设计、工艺验证、客户对接、批量生产全链条工作能力，可以支撑当前业务扩张与中长期研发迭代需求。

**Q6、请介绍目前液冷业务的产能建设情况及后续扩产规划。**

答：公司液冷业务生产基地位于惠州，目前已通过自有资金完成首期建设，现有厂房相关产线满足现阶段客户交付需求的能力。二期厂房已纳入规划，后续将根据客户订单放量节奏适时启动建设与装修，届时整体产能将大幅提升以承接更大规模订单。公司正根据业务发展规划逐步扩充相关设备产能，公司整体产能建设将与业务放量节奏保持匹配，后续也结合募投项目进一步扩大产能，项目落地后将大幅提升规模化交付能力，匹配全球算力液冷增量需求。

**Q7、请介绍目前液冷产品的毛利率水平。**

答：相关产品在不同生命周期阶段的价格和毛利存在差异，目前公司液冷业务尚处于小批量订单交付阶段，当前毛利率与净利率水平受制于初期生产规模，暂不能客观反映业务整体的盈利能力。随着下游终端客户新一代高性能计算平台进入大规模量产及出货阶段，公司跟随合作伙伴节奏有望受益放量出货，将对公司毛利有积极影响。

**Q8、液冷业务从当前到明年的收入预期如何？**

答：公司液冷业务的整体放量节奏与台湾合作伙伴的交付排期高度关联。公司核心客户在北美头部半导体公司中占有一定份额，公司作为其核心供应商，将直接受益于其液冷模组的放量。根据目前与核心客户的沟通及行业市场信息，公司液冷业务将在下半年有较好的预期，2027年随着新一代产品的量产推进，按照相关量价假设推算，预计仍将有较大幅度的增长空间。公司实际收入规模受客户最终订单量、产品价格、量产节奏等多重因素影响，具有一定不确定性，敬请广大

	<p>投资者理性投资，注意风险。</p> <p><b>Q9、请介绍公司向国内液冷市场拓展的进展。</b></p> <p>答：在国内市场，公司已积极拓展与头部服务器厂商、互联网企业的合作。目前公司已向国内头部算力基础设施厂商送样，国内市场液冷散热需求同样强劲，公司将依托在海外市场积累的技术能力和产品经验，逐步拓展国内市场份额。</p> <p><b>Q10、微通道封装盖板（MLCP）技术进展与长期战略价值如何？</b></p> <p>答：MLCP（微通道封装盖板）是下一代芯片级散热技术路线，将微米级冷却通道集成至芯片封装内部，大幅缩短冷却液与芯片热源距离，适配先进封装高功耗算力芯片。MLCP技术工艺壁垒高，公司依托封装材料工艺、蚀刻、钎焊工艺等积累具备天然协同优势，产品竞争力本质体现在综合制造能力与工艺深耕积淀，公司前瞻性布局MLCP领域，有望在下一轮产品迭代周期中构筑先发优势，占据更有利的竞争位置。</p> <p><b>Q11、公司向特定对象发行股票的进展情况？</b></p> <p>答：公司于2026年1月17日披露了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，拟募集资金总额不超过8亿元，主要用于液冷散热系统产业化项目、液冷研发中心及集团信息化建设项目、半导体封装材料扩产项目及补充流动资金。该定增方案已于2026年2月临时股东会审议通过，目前正与中介机构按计划有序推进，后续尚需深圳证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册后方可实施。</p>
<p>风险提示</p>	<p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026-6-27</p>